

문서번호: 제20190523호

수 신:

참 조:

발 신: 테크포럼(주)

제 목: '차세대 고방열/내열 소재/부품 기술 및 최신동향 세미나' 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 테크포럼은 5월 23일(목) 오전 10시에 한국기술센터 16층 국제회의실에서 '차세대 고방열/내열 소재/부품 기술 및 최신동향 세미나' 를 개최합니다.
3. 본 세미나에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

- 아 래 -

- 가. 행사명: 차세대 고방열/내열 소재/부품 기술 및 최신동향 세미나  
나. 일시: 2019년 5월 23일(목) 10시~17시  
다. 장소: 한국기술센터 16층 국제회의장  
라. 주최/주관: 테크포럼  
마. 세부일정

시간	주제
10:00~10:50 [트랙1]	나노탄소 복합소재 기반 고방열 기술개발 및 적용사례와 상용화 동향
11:00~11:50 [트랙2]	차세대 모바일 디바이스 방열이슈 대응을 위한 고기능성 접착소재의 기술 개발 동향 및 전망
12:00~12:50 [트랙3]	고방열 고분자 복합소재 기술개발 동향
14:00~14:50 [트랙4]	나노카본과 방열
15:00~15:50 [트랙5]	수소, 전기, 자율주행차 전장부품용 고방열/내열 소재/부품 이슈와 대응기술
16:00~16:50 [트랙6]	전자소자/LED 분야 고방열 소재/부품 기술 개발 동향 및 적용 사례

※ 발표 주제 및 일정은 연사/주최측의 사정에 의해 공지 없이 변경될 수 있습니다.

바. 등록비

- A. 사전결제: 253,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함) - 5월 22일(수) 18시까지
- B. 현장결제: 286,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함)

테크포럼(주)

